

2023-2029年中国芯粒（Chiplet）行业市场运行态势及未来前景规划报告

报告大纲

一、报告简介

智研咨询发布的《2023-2029年中国芯粒（Chiplet）行业市场运行态势及未来前景规划报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/1140625.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

智研咨询发布的《2023-2029年中国芯粒（Chiplet）行业市场运行态势及未来前景规划报告》共九章。首先介绍了芯粒（CHIPLET）行业市场发展环境、芯粒（CHIPLET）整体运行态势等，接着分析了芯粒（CHIPLET）行业市场运行的现状，然后介绍了芯粒（CHIPLET）市场竞争格局。随后，报告对芯粒（CHIPLET）做了重点企业经营状况分析，最后分析了芯粒（CHIPLET）行业发展趋势与投资预测。您若想对芯粒（CHIPLET）产业有个系统的了解或者想投资芯粒（CHIPLET）行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 芯粒（Chiplet）产业相关概述

1.1 芯片封测相关介绍

1.1.1 芯片封测概念界定

1.1.2 芯片封装基本介绍

1.1.3 芯片测试主要内容

1.1.4 芯片封装技术迭代

1.2 芯粒（Chiplet）基本介绍

1.2.1 芯粒基本概念

1.2.2 芯粒发展优势

1.2.3 与SoC技术对比

1.3 芯粒（Chiplet）技术分析

1.3.1 Chiplet集成技术

1.3.2 Chiplet互连技术

1.3.3 Chiplet封装技术

第二章 2018-2022年Chiplet产业发展综合分析

2.1 Chiplet产业发展背景

2.1.1 中国芯片市场规模

2.1.2 中国芯片产量规模

2.1.3 中国芯片产业结构

- 2.1.4 中国芯片贸易状况
- 2.1.5 中美芯片战的影响
- 2.2 Chiplet产业发展综述
 - 2.2.1 Chiplet芯片设计流程
 - 2.2.2 主流Chiplet设计方案
 - 2.2.3 Chiplet技术标准发布
 - 2.2.4 Chiplet市场参与主体
- 2.3 Chiplet产业运行状况
 - 2.3.1 Chiplet市场规模分析
 - 2.3.2 Chiplet器件销售收入
 - 2.3.3 Chiplet市场需求分析
 - 2.3.4 Chiplet企业产品布局
 - 2.3.5 Chiplet封装方案布局
- 2.4 Chiplet产业生态圈构建分析
 - 2.4.1 UCle产业联盟成立
 - 2.4.2 通用处理器企业布局
 - 2.4.3 云厂商融入Chiplet生态
 - 2.4.4 生态标准需持续完善

第三章 2018-2022年中国芯片封测行业发展分析

- 3.1 中国芯片封测行业发展综述
 - 3.1.1 行业重要地位
 - 3.1.2 行业发展特征
 - 3.1.3 行业技术水平
 - 3.1.4 行业利润空间
- 3.2 中国芯片测封行业运行状况
 - 3.2.1 市场规模状况
 - 3.2.2 市场竞争格局
 - 3.2.3 企业市场份额
 - 3.2.4 封装价格状况
- 3.3 中国先进封装行业发展分析
 - 3.3.1 行业发展优势
 - 3.3.2 市场规模状况
 - 3.3.3 市场竞争格局
 - 3.3.4 行业SWOT分析

3.3.5 行业发展建议

3.4 中国芯片封测行业发展前景趋势

3.4.1 测封行业发展前景

3.4.2 封装技术发展趋势

3.4.3 先进封装发展前景

3.4.4 先进封装发展方向

第四章 2018-2022年半导体IP产业发展分析

4.1 半导体IP产业基本概述

4.1.1 产业发展地位

4.1.2 产业基本概念

4.1.3 产业主要分类

4.1.4 产业技术背景

4.1.5 产业影响分析

4.2 半导体IP产业运行状况

4.2.1 产业发展历程

4.2.2 市场规模状况

4.2.3 细分市场发展

4.2.4 产品结构占比

4.2.5 市场竞争格局

4.2.6 市场需求分析

4.2.7 商业模式分析

4.2.8 行业收购情况

4.3 半导体IP产业前景展望

4.3.1 行业发展机遇

4.3.2 行业需求前景

4.3.3 行业发展趋势

第五章 2018-2022年EDA行业发展分析

5.1 全球EDA行业发展状况

5.1.1 行业基本概念

5.1.2 行业发展历程

5.1.3 市场规模状况

5.1.4 产品构成情况

5.1.5 区域分布状况

5.1.6 市场竞争格局

5.2 中国EDA行业发展综述

5.2.1 行业发展历程

5.2.2 产业链条剖析

5.2.3 行业制约因素

5.2.4 行业进入壁垒

5.2.5 行业发展建议

5.3 中国EDA行业运行状况

5.3.1 行业支持政策

5.3.2 市场规模状况

5.3.3 行业人才情况

5.3.4 市场竞争格局

5.3.5 行业投资状况

5.4 中国EDA行业发展前景展望

5.4.1 行业发展机遇

5.4.2 行业发展前景

5.4.3 行业发展趋势

第六章 2018-2022年国际Chiplet产业重点企业经营状况分析

6.1 超威半导体（AMD）

6.1.1 企业发展概况

6.1.2 产品发布动态

6.1.3 企业经营状况分析

6.2 英特尔（Intel）

6.2.1 企业发展概况

6.2.2 企业经营状况分析

6.3 台湾集成电路制造股份有限公司

6.3.1 企业发展概况

6.3.2 企业经营状况分析

第七章 中国Chiplet产业重点企业经营状况分析

7.1 芯原微电子（上海）股份有限公司

7.1.1 企业发展概况

7.1.2 经营效益分析

7.1.3 业务经营分析

7.1.4 财务状况分析

7.1.5 核心竞争力分析

7.1.6 公司发展战略

7.2 江苏长电科技股份有限公司

7.2.1 企业发展概况

7.2.2 经营效益分析

7.2.3 业务经营分析

7.2.4 财务状况分析

7.2.5 核心竞争力分析

7.2.6 公司发展战略

7.3 天水华天科技股份有限公司

7.3.1 企业发展概况

7.3.2 经营效益分析

7.3.3 业务经营分析

7.3.4 财务状况分析

7.3.5 核心竞争力分析

7.3.6 公司发展战略

7.4 通富微电子股份有限公司

7.4.1 企业发展概况

7.4.2 经营效益分析

7.4.3 业务经营分析

7.4.4 财务状况分析

7.4.5 核心竞争力分析

7.4.6 公司发展战略

7.5 中科寒武纪科技股份有限公司

7.5.1 企业发展概况

7.5.2 经营效益分析

7.5.3 业务经营分析

7.5.4 财务状况分析

7.5.5 核心竞争力分析

7.5.6 公司发展战略

7.6 北京华大九天科技股份有限公司

7.6.1 企业发展概况

7.6.2 经营效益分析

7.6.3 业务经营分析

7.6.4 财务状况分析

7.6.5 核心竞争力分析

7.6.6 公司发展战略

第八章 中国Chiplet产业典型相关投资项目深度解析

8.1 集成电路先进封装晶圆凸点产业化项目

8.1.1 项目基本概况

8.1.2 项目投资必要性

8.1.3 项目投资可行性

8.1.4 项目投资概算

8.1.5 项目经济效益

8.2 高密度微尺寸凸块封装及测试技术改造项目

8.2.1 项目基本概况

8.2.2 项目投资必要性

8.2.3 项目投资可行性

8.2.4 项目投资概算

8.2.5 项目进度安排

8.3 高性能模拟IP建设平台

8.3.1 项目基本概况

8.3.2 项目投资可行性

8.3.3 项目投资概算

8.3.4 项目进度安排

第九章 对2023-2029年中国Chiplet产业投资分析及发展前景预测

9.1 中国Chiplet产业投资分析

9.1.1 企业融资动态

9.1.2 投资机会分析

9.1.3 投资风险提示

9.2 中国Chiplet产业发展前景

9.2.1 行业发展机遇

9.2.2 产业发展展望

图表目录

图表 集成电路封装实现的四大功能

图表 集成电路测试的主要内容

图表 集成电路测试可分为晶圆测试和成品测试

图表 集成电路封装技术发展阶段

图表 Chiplet内部结构

图表 Chiplet技术主要功能分析

图表 服务器CPU、GPU裸Die尺寸逐渐增大

图表 晶圆利用效率和芯片良率随着芯片面积缩小而提升

图表 基于7nm工艺的传统方案及Chiplet方案下良率及合计制造成本对比

图表 SoC技术与Chiplet技术关系示意图

图表 Chiplet及单片SoC方案环节对比

图表 水平和垂直方向集成的Chiplet的结构

图表 Chiplet中SerDes互连电路结构

图表 Chiplet并行互连电路结构

图表 当前Chiplet间主要互连方案比较

图表 先进封装技术对比

图表 主流Chiplet底层封装技术

图表 2018-2022年中国集成电路产业销售额及增速

图表 2018-2022年中国集成电路产量统计图

图表 2018-2022年中国集成电路产业结构

图表 2018-2022年中国集成电路进口数量及增速

图表 2018-2022年中国集成电路进口金额及增速

图表 Chiplet芯片设计流程

图表 主流Chiplet设计方案

图表 中国Chiplet产业主要参与者介绍

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/1140625.html>